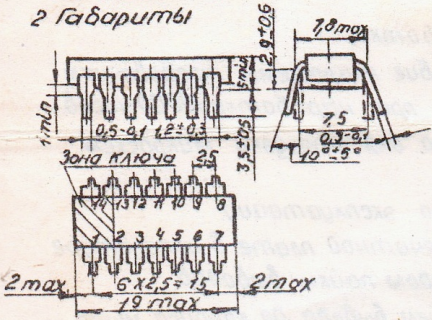


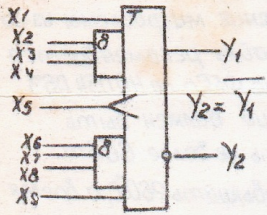
Паспорт  
Микросхема К1ТК 551

Соответствует частным техническим условиям БКО.340.006ТУ

1. Функциональное назначение - триггер J-К с логикой на входе "3И"
2. Габариты



3. Вес микросхемы не более 1г



Вкл-Бод	Назначение
1	←
2	Вход установки 0" X1
3	Вход X2 (J1)
4	Вход X3 (J2)
5	Вход X4 (J3)
6	Выход Yx2
7	Общий
8	Выход Y1
9	Вход X5 (K1)
10	Вход X7 (K2)
11	Вход X8 (K3)
12	Вход синхронизации X5
13	Вход установки 1" X9
14	Питание +E

Вход X2, X3, X4	Вход X5, X7, X8	Время до прихода синхрон. импульса tп	Время после прихода синхрон. импульса tн+1
0	0	Y1	Y2
1	0	1	1
0	1	0	0
1	1	Y2	Y2

4. Содержание золота в одной микросхеме 0,00703г.
5. Напряжение питания E = +5В ± 5%
6. Электрические параметры при температуре +20 ± 5°C

Наименование	Норма
Нагрузочная способность, N	10
Выходное напряжение „лог.0" U"вых,в, не более	0,4
Выходное напряжение „лог.1" U"вых,в, не менее	2,4
Максимальная частота деления fмах, мГц, не более	10

Предельно-допустимые условия эксплуатации:  
Диапазон рабочей температуры от минус 10 до +70°C.  
Предельно-допустимое кратковременное напряжение  
питания составляет 76 в течение времени 5 миллисекунд.

Срок хранения - 12 лет.

Время гарантийной наработки.

Гарантируется соответствие микросхемы требованиям  
частых технических условий при наработке 10000 часов.

Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхем  
потребителю.

Указания и рекомендации по эксплуатации.

Крепление микросхемы к печатной плате в аппаратуре  
может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микро-  
схемы должно быть не менее 2,5 мм. Пайку следует производить  
с принятием мер исключающих повреждение микросхемы из-за  
перегрева и механических усилий. При пайке рекомендуется  
применять припой ПОС-61 ГОСТ 499-70 флюс ФКСп по НО.054.063.

При пайке с помощью паяльника последний должен быть  
обязательно заземлен и иметь мощность не более 60 Вт.

При пайке температура не должна превышать 260°C, а время  
воздействия этой температуры на микросхему не более 5 сек.

При монтаже руководствоваться указаниями черт. 0.308.008 ГЧ.

После монтажа микросхема должна быть защищена в  
соответствии с нормалью НО.054.021. С целью повышения на-  
дежности аппаратуры рекомендуется принимать меры, обеспе-  
чивающие минимальную температуру нагрева корпуса  
микросхем и защиту от воздействия климатических факто-  
ров. При ремонте аппаратуры смену микросхем необходимо  
производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска

Штамп ОТК

